

引領產業創新優勢 前瞻時代變動的商機

SEMICON Taiwan 先進製程技術論壇、系統級封測國際高峰論壇

重量級講師 探究劃時代半導體產業脈動



【2016年9月2日】SEMICON Taiwan 國際半導體展，將於今年9月7到9日於台北南港展覽館一館舉行，展預期將聚集超過600家國內外廠商參展，並吸引超過43,000參觀者到現場參觀。SEMI(國際半導體產業協會)為提供多元且精準的展覽內容，共規劃17個主題展區以及逾22場國際論壇，期望幫助參觀者與國際接軌，有效連結客戶與供應商，展示最新技術與產品，同時促進微電子產業未來進步與發展。因應消費性產品發展趨勢及物聯網的整合需求，SEMICON Taiwan 今年更聚焦半導體先進封裝製程技術，規劃一系列的論壇與活動。

台積電先進模組技術發展處資深處長 - 余振華在今年7月的SEMICON West談話中表示，台積電一直以來被稱為全球晶圓代工的龍頭，但隨著時代變遷，台積電將轉型成領先業界的系統級封裝晶圓製造公司。余振華資深處長進一步指出，「隨著摩爾定律的挑戰變得更佳艱困，發展先進封裝技術儼然已成為維持競爭力必要手段。」資料指出，拜導入晶圓封裝技術所賜，台積電產品在速度及封裝厚度上改善了20%，在耐熱的表現上也提升了10%。今年的SEMICON Taiwan 期望透過一系列以先進封裝技術為主題的論壇與活動，邀請來自台積電、聯電、日月光、矽品、艾可爾(Amkor)、柯林研發(Lam Research)等業

界領導廠商，幫助與會者從技術的演進與突破到後端應用衍生的龐大商機，全盤了解先進封裝技術對於半導體產業發展的影響。

因應現今消費電子產品輕薄小且高效能的趨勢，將多種不同功能的晶片整合於單一模組中，是所有封測廠商所面臨的重要挑戰之一。在 9 月 7 日上午，「先進封裝技術論壇」以扇外型晶圓封裝技術出發，針對成本效益與技術整合等關鍵議題，探討解決發展半導體先進封裝技術的機會與挑戰。於 9 月 8、9 日舉行之「SiP 系統級封測國際高峰論壇」，聚焦 2.5D/3D IC 技術、內埋與晶圓級封裝技術，剖析創新封裝技術如何解決傳統尺寸的限制，強化異質整合的能力，以符合未來極微縮產品的設計需求。

除了先進封裝技術的論壇主題外，針對市場資訊，SEMICON Taiwan 另規劃 CEO 高峰論壇與市場趨勢論壇，透過重量級講師的分享，引領高階主管開拓前瞻性的思維。在技術趨勢領域，則提供包括智慧製造、半導體材料、MEMS、記憶體科技、IC 設計、永續供應管理等多元主題論壇，使與會者快速了解最新國際產業脈動，有效提升台灣半導體競爭力。

SEMI 台灣區總裁曹世綸表示，「SEMICON Taiwan 國際論壇規劃多樣化的主題，從市場資訊到技術趨勢，聚焦熱門議題，邀請超過百位來自業界的菁英，深度剖析產業趨勢和技術動態，讓所有參與者都能迅速掌握全球市場動向！」

SEMICON Taiwan 2016 國際論壇活動一覽表

2016 年 9 月 7 日 星期三		
技術趨勢	08:30 – 17:00	<u>先進封裝技術論壇</u>
	13:00 – 17:00	<u>高科技產業永續發展論壇</u>
	13:00 – 17:00	<u>平坦化論壇</u>
	13:00 – 16:45	<u>半導體材料技術論壇</u>
市場資訊	09:20 – 17:00	<u>CEO 高峰論壇</u>
合作單位	13:00 – 17:00	<u>半導體永續供應管理論壇</u>

2016年9月8日 星期四		
技術趨勢	08:30 – 17:00	<u>高科技廠房設施國際論壇</u>
	08:30 – 17:00	<u>MEMS 論壇</u>
	08:30 – 17:00	<u>系統級封測國際高峰論壇 2016 - 2.5D / 3D IC 技術趨勢論壇</u>
	08:30 – 12:00	<u>WLCSP 的雷射應用及創新微加工技術研討會</u>
	13:00 – 17:00	<u>半導體智慧製造論壇</u>
市場資訊	08:30 – 12:00	<u>半導體市場趨勢論壇</u>
	08:30 – 12:00	<u>海外市場投資說明會</u>
	13:00 – 16:00	<u>財務長高峰論壇</u>
合作單位	09:00 – 17:00	<u>2016 國際半導體先進製程設備技術論壇暨商談媒合會</u>
	10:00 – 10:30	<u>聯電零配件需求與供應商一對一洽談</u>
	13:00 – 17:00	<u>海峽兩岸合作研討會</u>
2016年9月9日 星期五		
技術趨勢	08:30 – 17:30	<u>系統級封測國際高峰論壇 2016 - 內埋與晶圓級封裝技術論壇</u>
	08:30 – 16:25	<u>半導體先進製程科技論壇</u>
	08:30 – 13:30	<u>車用 X 設計論壇暨 IC 設計產業聯誼午宴</u>
	08:30 – 12:00	<u>記憶體科技論壇</u>

更多展會資訊，請至 SEMICON Taiwan 官方網站 www.semicontaiwan.org/en

關於 SEMI

SEMI 是全球化的產業協會，致力於促進微電子、平面顯示器及太陽能光電等產業供應鏈的整體發展。會員涵括上述產業供應鏈中的製造、設備、材料與服務公司，是改善人類生活品質的核心驅動力。**SEMI** 的服務項目包括：專業展會規劃、產業標準建立、市場研究調查、會員服務、教育訓練課程等。自 1970 年成立至今，**SEMI** 不斷致力於協助會員公司快速取得市場資訊、提高獲利率、創造新市場、克服技術挑戰，以及促進會員與其客戶、投資者、供應商、政府及全球產業精英的關係。**SEMI** 在全球 13 個重要微電子生產基地均設有辦公室，包括：新竹、上海、北京、東京、首爾、新加坡、邦加羅爾、布魯塞爾、

柏林、格勒諾布爾、莫斯科和聖荷西、華盛頓。更多市場研究與展會訊息請參訪
www.semi.org。

媒體聯絡人

SEMI Taiwan

廖苡真

電子信箱：jliao@semi.org

聯絡電話：03.560.1777 分機 201

SEMI Taiwan

易葦如

電子信箱：eyi@semi.org

聯絡電話：03.560.1777 分機 205

###